

EV GROUP Brings High-speed High-precision Metrology to 3D Heterogeneous Integration – November 17, 2021

EV GROUP將高速與高精度檢測導入3D異質整合

台灣產經新聞網 / 世紀奧美公關 2021.11.17 00:00

讚 0

A- A A+



EVG40 NT2提供突破性的檢測效能

加速晶圓與晶粒級的混合接合，以及無光罩微影的執行

EV Group企業技術總監Thomas Glinsner博士表示：「對於先進的3D和異質整合應用來說，製程的管控越來越重要。EVG40 NT2代表著檢測效能的重大突破，藉以滿足先進封裝產業的全新需求，其不僅能提供更高的疊層精確度，同時也大幅提升製程產能，將能促成每片晶圓更高的測量密度，提供如混合接合效能等更詳細的回饋資訊。此全新的檢測解決方案，使EVG針對3D/異質整合製程解決方案的產品組合更加完整，並與我們現有的EVG40 NT系統相得益彰。事實上，EVG40 NT系統目前仍是MEMS與複雜光子設備的接合檢測標準。EVG40 NT2在EVG的異質整合技術中心 (Heterogeneous Integration Competence Center™) 正在進行的數個共同開發案中，扮演關鍵的角色。」

高精度、高產能的檢測效能

EVG40 NT2系統為當前與未來的先進3D/異質整合應用，提供高精度的關鍵接合與微影製程參數的測量，包括W2W、D2W與D2D及無光罩曝光製程的對準驗證與監控、CD測量以及多層的厚度測量。這是一套具備高度擴充性的系統，具備多個測量頭，以及專為高產能及高精確度 (single-digit nm range) 接合與無光罩曝光對準驗證設計的高精度鏡組平台。針對對準驗證，EVG40 NT2將能產出可用於回饋系統的疊層模型，以提升整體的對準作業，其亦可以減少系統錯誤，達成更高的生產良率。這套系統相容於支援工業4.0製造的次世代晶圓生產所需的疊層回饋與晶粒位置前饋的多個生產線的最佳化概念。

產品供應時程

EVG現已開始接受全新EVG40 NT2自動化檢測系統的訂單，並在位於奧地利總部的EVG異質整合技術中心提供產品展示。更多相關資訊，請瀏覽：<https://www.evgroup.com/products/metrology/>。

關於EV Group (EVG)

EVG是全球半導體、微機電、化合物半導體、電源元件和奈米科技應用的晶圓製程解決方案領導廠商，主要產品包括晶圓鍵合、晶圓薄化、微影/奈米壓印微影技術 (NIL) 和檢測設備，以及光阻塗佈機、顯影機、晶圓清洗和檢測設備。EVG成立於1980年，藉由一個完備的全球網絡資源為全球的客戶和合作夥伴提供服務。更多相關資訊請參考公司網站：www.EVGroup.com。

<http://n.yam.com/Article/20211117191911>